

公司代码：688372

公司简称：伟测科技



**上海伟测半导体科技股份有限公司
关于本次募集资金投向
属于科技创新领域的说明**

二〇二六年五月

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）等相关规定，对公司本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，具体内容如下：

一、本次募集资金投资项目概述

公司本次发行拟募集资金总额不超过 200,000 万元（含 200,000 万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	伟测科技上海总部基地项目	98,740	70,000
2	伟测科技西南总部及研发测试基地项目	100,000	80,000
3	偿还银行贷款和补充流动资金	50,000	50,000
合计		248,740	200,000

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经公司股东会授权，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析

本次募集资金拟投资项目包括“伟测科技上海总部基地项目”及“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”，主要用于扩大公司集成电路测试产能，尤其是 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能；除此之外，公司拟使用剩余的募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析如下：

（一）“伟测科技上海总部基地项目”及“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”

1、项目实施的必要性

（1）继续加大 AI 算力芯片测试产能的建设，将其打造成为公司业绩增长的重要引擎，并为我国人工智能行业高端测试能力的自主可控提供有力保障

过去两年，面对人工智能产业爆发式增长带来的 AI ASIC 芯片、GPU、CPU 等 AI 算力芯片测试需求，公司坚持前瞻性扩产策略，通过引进国际先进测试设备、组建专业测试团队、建设高标准测试产线等举措，全面加码产能布局。截至 2025 年末，AI 算力芯片测试收入在公司营业收入中的占比已经初具规模。公司预计未来几年，AI 算力芯片测试需求仍将保持爆发式增长的态势。本次募投项目继续加大 AI 算力芯片测试产能的建设，一方面能够将其打造成为公司业绩增长的重要引擎，另一方面能够填补我国在该领域的产能缺口，有助于构建自主可控的测试技术体系，为我国人工智能产业筑牢质量根基，助力国产 AI 算力芯片在全球竞争中掌握核心话语权。

（2）响应现有客户的需求，扩大存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能，增强客户粘性，并增强公司的差异化竞争优势，打造新的业绩增长点

本次募投项目在重点强化 AI 算力芯片测试业务的同时，亦将部分资源倾斜至存储芯片、高端 CIS 芯片测试产能的建设。虽然这两类业务当前并非公司收入的主要来源，但凭借其卓越的成长潜力与有利的竞争态势，加之现有客户旺盛的测试需求，公司已将其视为关键的业务延伸方向。通过本次产能扩充，公司不仅能高效满足现有客户的增量需求，进一步巩固客户基础，更能借此优化业务组合，构建独特的差异化优势，为公司业绩的可持续增长打造新的业绩增长点。

（3）为公司业绩的持续增长提供产能保障，进一步巩固公司在行业中的领先地位

自 2016 年成立以来，公司的业绩保持了高速增长的态势，截至目前，公司已经发展成为中国大陆第三方集成电路测试领域中的领军企业。随着业务量不断上升，公司需要继续扩充测试产能才能保障业绩的持续增长。此外，集成电路行业具有“大者恒大”的规律，本次募投项目达产之后，预计能够大幅度增加公司的测试服务能力、营业收入和净利润规模，进一步巩固公司在行业中的领先地位。

2、项目实施的可行性

(1) 本次投资项目的下游市场前景广阔，为项目的实施提供了市场保障

本次募投项目主要投资于 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片三个下游方向。在 AI 算力芯片领域，随着 AI 从模型训练走向实际应用，推理需求呈几何级数增长，驱动产业进入“超级周期”。国产算力芯片已跨越“可用”拐点，正通过系统级创新从替代者转变为全球格局中不可忽视的参与者。在存储芯片领域，AI 大模型爆发使其升级为战略物资，引发全球供需失衡。我国产业正处于 AI 驱动与国产替代交汇的机遇期，有望在未来 5-10 年开创“中国存储时代”。在高端 CIS 芯片领域，该技术长期被国外垄断，主要应用于旗舰级消费电子产品的摄像头，国内领先企业实现突破后销量大幅增长，配套的测试需求十分旺盛。综上，本次投资项目的下游市场前景广阔，为项目的实施提供了市场保障。

(2) 公司拥有经验丰富、专业能力过硬的经营和技术团队，为项目的实施提供了人才保障

公司的核心团队深耕集成电路行业二十余年，是国内最早从事集成电路测试的一批资深人士。团队主要成员曾先后在摩托罗拉、日月光、长电科技等全球知名半导体企业或封测龙头企业从事测试业务技术研发和管理工作，拥有深厚的专业背景，对各类芯片测试拥有丰富的实践经验和技术积累，并且在市场研判、行业理解等方面具备领先于同行业的洞察力，为本项目的实施提供了人才保障。

(3) 本次募投项目的产能主要服务于公司现有客户，项目的实施已经具备良好的客户基础

在 AI 算力芯片领域，经过 2 年多的开拓和积累，公司已经与国内主要的 AI 算力芯片厂商建立了业务合作关系，具体包括 AI ASIC 芯片龙头企业、GPU 新锐厂商、自研 AI 芯片的云计算厂商、智能驾驶 AI 芯片厂商四大类客户。此外，公司也与多家 AI 服务器 CPU 厂商建立了稳定的业务合作关系。在存储芯片领域，公司已经服务于兆易创新、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等国内知名存储芯片客户。在高端 CIS 芯片领域，本次新增产能将主要服务于公司的第一大客户。综上，本次募投项目的产能主要服务于公司现有客户，项目的实施已经具备良好的客户基础。

(二) 偿还银行贷款及补充流动资金

1、项目实施的必要性

截至 2026 年 3 月 31 日，公司短期借款余额为 55,557.16 万元，长期借款余额为 270,065.99 万元，一年内到期的非流动负债余额为 35,209.74 万元，有息负债总额超过 36 亿元，偿债压力较大。此外，最近三年一期，公司营业收入分别为 73,652.48 万元、107,686.99 万元、157,464.24 万元及 48,997.56 万元，年均复合增长率 46.22%。随着公司经营规模的稳步扩张，所需营运资金规模将不断增加。因此，本次偿还银行贷款及补充流动资金能有效缓解公司偿债压力，优化公司资本结构，解决公司发展过程中的资金需求问题，优化资本结构、减轻财务负担，进一步提高公司抗风险能力和公司综合竞争力，为提升持续盈利能力提供保障。

2、项目实施的可行性

(1) 公司内控完善，募集资金管理相关制度规范

公司建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专项储存、使用作出了明确的制度安排，以在制度上保证募集资金的规范使用。

(2) 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金符合法律法规的规定

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金符合相关法律法规的规定，具备可行性。本次发行可转换公司债券偿还银行贷款及补充流动资金的总金额为 50,000 万元。除此以外，本次募投项目“伟测科技上海总部基地项目”及“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”中包含的预备费及铺底流动资金，属于非资本性支出。上述金额合计占募集资金总额的比例未超过 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。

三、募集资金投资项目的具体情况

(一) 伟测科技上海总部基地项目

1、项目概况

“伟测科技上海总部基地项目”的实施主体为上海伟测半导体科技股份有限公司，总投资额为 98,740 万元，拟使用本次募集资金金额为 70,000 万元。本项目拟在上海购买土地、新建厂房并配置相关测试设备，重点购置 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试机台，提升公司在上述方向的服务能力。

2、建设内容及投资概算

本次募投项目之“伟测科技上海总部基地项目”的投资总额为 98,740 万元，拟投入募集资金 70,000 万元。

3、项目建设用地及项目备案、环评情况

截至本报告出具日，公司已取得本项目建设地所属地块的不动产权证书及已完成项目备案和环评批复的相关工作。

(二) 伟测科技西南总部及研发测试基地项目

1、项目概况

“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”的实施主体为全资子公司成都伟测半导体科技有限公司，总投资额为 100,000 万元，拟使用募集资金投资额为 80,000 万元。本项目拟在成都购置土地、新建厂房并配置相关测试设备，重点购置 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试机台，提升公司在上述方向的服务能力。

2、建设内容及投资概算

本次募投项目之“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”的投资总额为 100,000 万元，拟投入本次募集资金 80,000 万元。

3、项目建设用地及项目备案、环评情况

截至本报告出具日，公司已完成项目备案的相关工作，项目建设用地及环评批复的相关工作正在办理中。

(三) 偿还银行贷款和补充流动资金

公司综合考虑了自身经营状况以及业务发展规划等情况，拟将本次募集资金中的 50,000 万元用于偿还银行贷款及补充流动资金，以缓解公司偿债压力、满足公司资金需求，降低经营风险，保持公司持续、健康、稳定发展。

四、本次募集资金投向科技创新领域的说明

（一）本次募集资金投资于科技创新领域的说明

本次募集资金均用于公司主营业务集成电路测试领域。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属的行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”大类下的“C3973集成电路制造”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，本次募投项目所属领域为“1新一代信息技术产业”之“1.2电子核心产业”之“1.2.4集成电路制造”，属于国家战略及政策重点支持发展的科技创新领域。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，本次募投项目所属领域属于第五条规定的“新一代信息技术领域”，符合科创板的行业范围。

因此，本次募集资金投向属于科技创新领域。

（二）募集资金投资项目实施促进公司科技创新水平的方式

通过本次募投项目的实施，公司将进一步实现集成电路测试尤其是AI算力芯片、存储芯片、高端CIS芯片的测试产能的扩张，进一步提升公司测试方案的开发能力，提高公司核心技术水平和产品竞争力，促进主营业务发展，并促进公司科技创新水平的持续提升。

未来公司将持续加大研发投入，重点针对AI算力芯片、存储芯片、高端CIS芯片的测试等方向，着重突破各类芯片的测试难点，为公司持续发展注入新动能。

综上，本次发行是公司顺应行业发展趋势，加强和扩大核心技术及业务优势，实现公司战略发展目标的重要举措。公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务及相关领域开展，募集资金投向属于科技创新领域，符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条第（四）条的相关规定。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日